

來頡科技股份有限公司 上市前業績發表會

2022年4月14日

主辦券商:  元大證券 *Yuanta Securities*

風險事項

一、產業風險

(一)產品生命週期隨市場產品規格變化而縮短

研發團隊持續往高階製程推進，藉以強化產品競爭力。同時加強人員的培訓、提高人力素質，以提高整體研發能力。公司於規劃新產品時，應用領域廣泛使用為主要考量，晶片架構設計預留封裝、外部電路及控制韌體的彈性；可以根據市場需求變化，提供完整的應用系統設計方案，減少全新晶片開發的資源投入。

二、營運風險

(一)同業競爭風險

本公司之產品已獲得主晶片廠之認證，舉凡在產品規格及品質均獲得終端客戶的信賴，並與客戶建立策略性夥伴關係。研發團隊將持續開發具差異化、高功能規格之產品，並持續往高階製程推進，藉以強化產品競爭力。

(二)有關智產權之風險

本公司主要針對核心技術申請並取得專利，藉此保護本公司智慧財產及研發成果。而為了保護核心技術之專利，本公司亦針對此技術之其它多項類似應用申請專利，藉此保護本公司之核心專利。

風險事項

(三)營業秘密外流之風險

本公司將研發之核心技術儲存於研發專用伺服器，由專網專線控管，僅能透過區域網路之方式連線至伺服器。另外該網路線並無連接至一般網際網路及封鎖USB存取之功能，禁止其透過USB存取方式將資料攜出。研發團隊在上傳研發成果歸檔之文件時，僅能由總經理或資訊部主管於開啟FTP後進行單向傳輸，並於使用後立即關閉。

(四)類比IC設計人才缺乏

本公司推行人性化管理制度，除致力提供好的工作環境、順暢的升遷管道及良好福利制度外，並提供分紅認股讓員工分享企業經營獲利的成果。另外並提供員工完整的教育訓練以培養多元化人才，以及完善溝通管道，持續優化員工福利制度加強員工對公司的認可與向心力，以降低員工流動率。

三、其他重要風險

請參閱本公司公開說明書「壹、二、風險事項」之說明。

補充揭露事項

依據臺灣證券交易所股份有限公司111年1月21日臺證上一字第 1111800324 號函，應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：

- (一)最近三年度及截至最近期業績變化之合理性
- (二)進銷貨集中於特定對象之緣由、風險暨因應措施

相關說明請參閱本公司公告於公開資訊觀測站「現金增資發行新股申報用之公開說明書」

公司治理及企業社會責任

本公司公司治理及企業社會責任均依照主管機關制定之相關法令規定執行，相關說明請參閱本公司公告於公開資訊觀測站之現金增資發行新股申報用之公開說明書及年度報告書

免責聲明

- 本簡報係公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在與未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性結論大為不同。
- 所提供之資訊（包括對外來的看法），並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。

簡報綱要

01 | 公司簡介

02 | 經營實績與
營運概況

03 | 產品應用與
市場概況

04 | 競爭優勢與核
心技術

05 | 未來發展

公司簡介

公司基本資料

里程碑

集團架構

董事會成員及主要經營團隊

我們的核心價值

公司基本資料

公司名稱：來頡科技股份有限公司

成立日期：2010年09月07日

董事長：陳燦榮

總經理：孟達

實收資本額：新台幣367,291,330元

主力產品：Power Management IC

Certification：ISO-9001:2015

員工總人數：66人(RD 38人)



里程碑

公司中文名稱更名為來頡科技
轉投資西安來頡子公司
獲ISO9001認證
投入開發6吋晶圓代工廠
產品跨足行動電源市場

轉投資M3 Dallas子公司
產品獲兩家美系主晶片大廠分別認證於WiFi5及WiFi 6平台
產品跨足固態硬碟市場

投入開發新8吋晶圓
投入開發12吋晶圓
產品獲美系主晶片大廠認證於WiFi 6E平台
投入開發適用於WiFi 7之產品



2010

M3Tek 公司成立，中文名稱邁鑫科技

2011-2013



引進策略性投資人- 聯陽半導體
收購聯陽半導體電源管理IC事業部，
跨足網通市場



2014-2015

投入開發新6吋晶圓代工廠
投入開發8吋晶圓代工廠
產品獲美系主晶片大廠認證於WiFi 5平台



2016-2017



2018-2019

投入開發新8吋晶圓代工廠
產品跨足USB Type-C市場



2020-Now

集團架構

來頡科技股份有限公司

註冊地：臺灣

100%

M3 Technology (Dallas), Inc.

註冊地：美國

100%

Blink Electronic Co., Ltd.

註冊地：薩摩亞

100%

西安來頡半導體有限公司

註冊地：中國

董事會成員

	職稱	姓名	主要學經歷	持股比例
1	董事長	陳燦榮	美國加州大學伯克萊分校電子工程碩士 邁肯(股)公司 總經理	23.5%
2	董事	孟達	新墨西哥州大學電子工程碩士 Maxim Integrated Products Inc. 高級工程師 Monolithic Power Systems Inc. 設計副總 來頡科技(股)公司 總經理	-
3	董事	聯陽半導體(股)公司 代表人 林弘堯	交通大學高階管理碩士 聯陽半導體(股)公司 總經理	5.5% -
4	董事	九鼎創業投資(股)公司 代表人 鄭培毓	清華大學工程與系統科學研究所碩士 益鼎創業投資管理顧問有限公司 業務副總經理	6.2% 0.1%
5	獨立董事	郭江龍	交通大學電子物理系學士 德州儀器半導體技術(上海)有限公司 董事總經理	-
6	獨立董事	江志烽	淡江大學會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所審計部 協理 志璟會計師事務所 會計師	-
7	獨立董事	畢祖明	中山大學財務管理研究所碩士 台達資本股份有限公司 協理	-

主要經營團隊

	職稱	姓名	主要學經歷	持股比例
1	總經理兼 臺灣研發主管	孟達	新墨西哥州大學電子工程碩士 Maxim Integrated Products Inc. 高級工程師 Monolithic Power Systems Inc. 設計副總	-
2	西安研發主管	席小玉	美國愛荷華州立大學電子與電腦工程碩士 Texas Instruments Inc. 設計工程師 Monolithic Power Systems Inc. 資深設計經理	-
3	品保部協理	吳宗錦	臺灣科技大學機械工程學士 德信科技(股)公司 品保經理 乘遠股份有限公司 品保經理	0.2%
4	生產部資深協理	彭炳銘	中華大學電機系學士 德信科技(股)公司 測試部經理 立錡科技(股)公司 生產技術處/總經理室 經理	1.0%
5	業務一部資深協理	莊仁生	國立政治大學企業管理學學士 Monolithic Power System Inc. Taiwan Branch 業務副理 聯陽半導體(股)公司 資深業務經理	1.1%

主要經營團隊

	職稱	姓名	主要學經歷	持股比例
6	業務二部協理	謝建民	國立台北科技大學工業工程與管理系學士 凌耀科技(股)公司 業務處長 鹽光股份有限公司 資深業務經理	0.1%
7	應用工程處長	胡昇明	台灣工業技術學院電子工程學系學士 晶翰科技(股)公司 應用部經理 聯陽半導體(股)公司 應用部資深經理	0.3%
8	市場技術部協理	呂志健	龍華科技大學工程學院電子工程學系學士 德信科技(股)公司 FAE經理 Diodes Inc. FAE經理	0.3%
9	財務部協理	黃淑慧	英國萊斯特大學碩士 中磊科技(股)公司 會計副理 Alpha & Omega Semiconductor Ltd 資深財務經理	0.4%
10	產品架構協理	楊勃	維吉尼亞理工大學博士 Monolithic Power Systems Inc. 資深芯片設計工程師 Diodes Inc. 系統架構工程師 NuVolta Technologies Inc. 首席系統架構師	-

主要經營團隊

	職稱	姓名	主要學經歷	持股比例
11	稽核經理	廖英貞	淡江大學學士 尚茂電子材料(股)公司 稽核副理 晶心科技(股)公司 稽核經理	-
12	總經理特助	吳曉玫	中原大學 碩士 合作金庫人壽保險(股)公司 電話行銷業務主管 麥奇數位(股)公司 業務行政資深總監	-

我們的核心價值

誠信 Integrity



創新 Innovation



合作 Team Work



服務 Services



品質 Quality



Core Value Analysis

Encourage Innovation
鼓勵員工勇於創新

Make a Difference and Maximize Our Potentials
與眾不同，積極主動進取

Listen and Satisfy Customers' needs
聆聽客戶需求，提供優質服務

經營實績與營運概況

銷售區域分布

經營實績

主要產品收入分布

銷售區域分布



4.9%

歐洲

愛爾蘭、葡萄牙

16.2%

亞洲

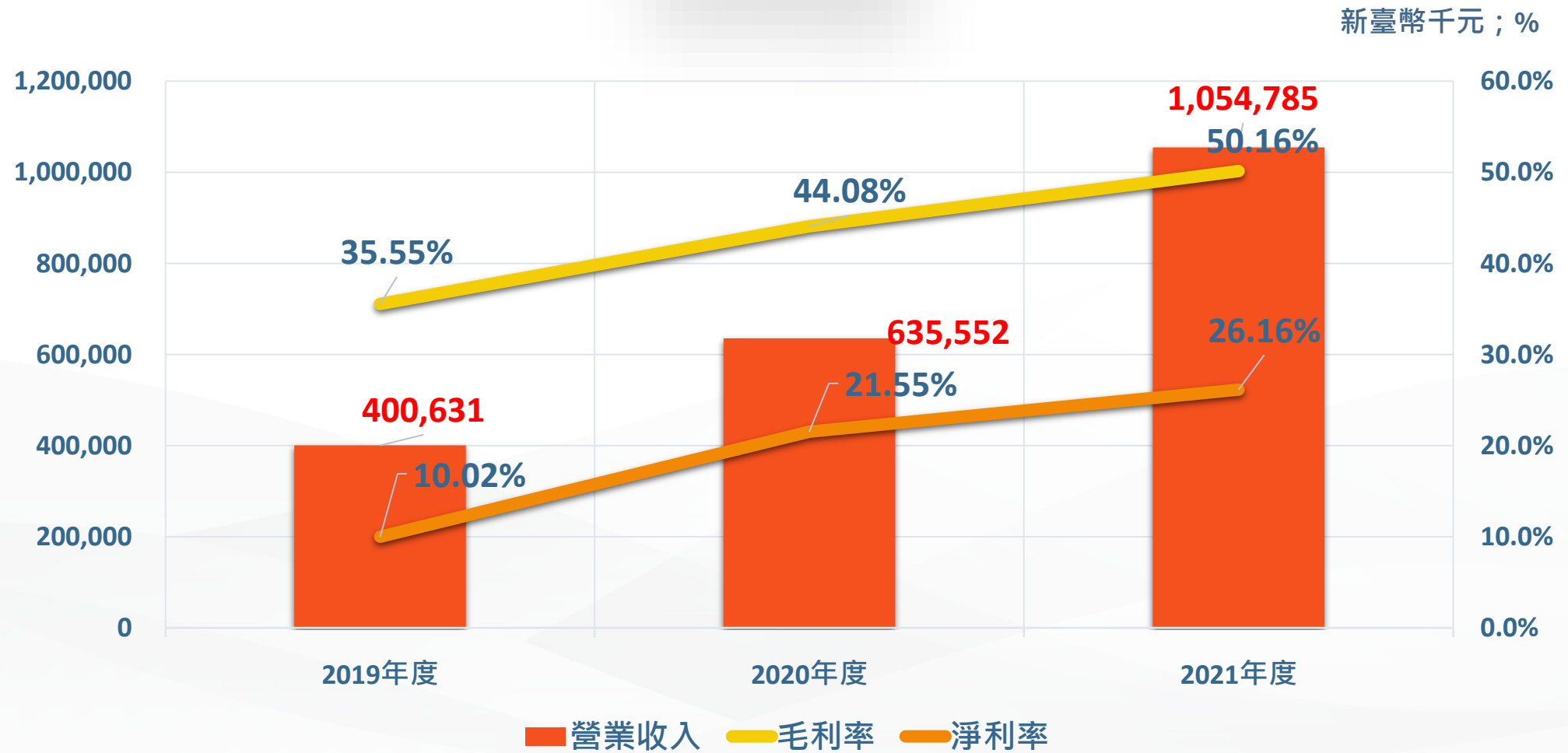
中國、香港、韓國
、越南

78.9%

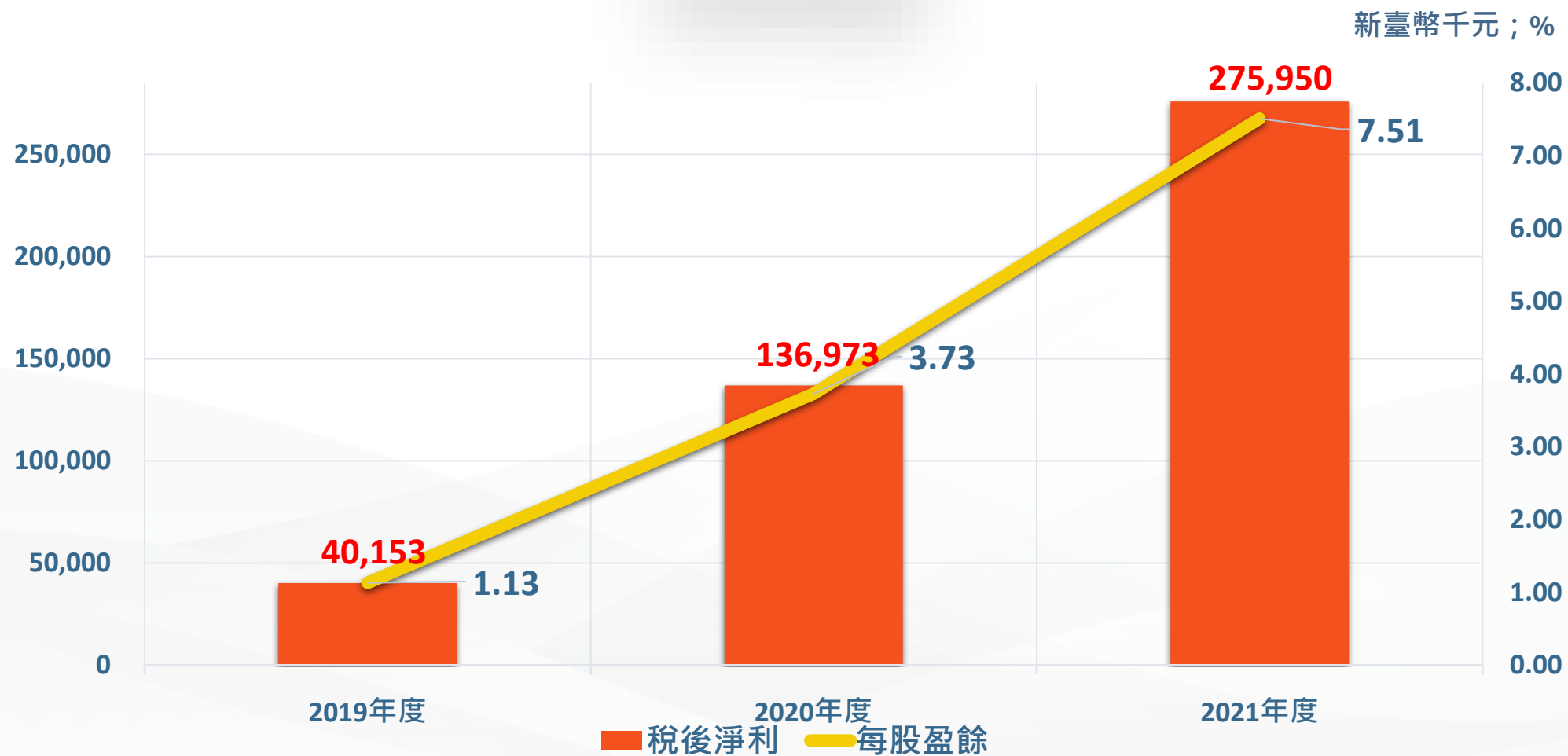
臺灣

臺灣

經營實績

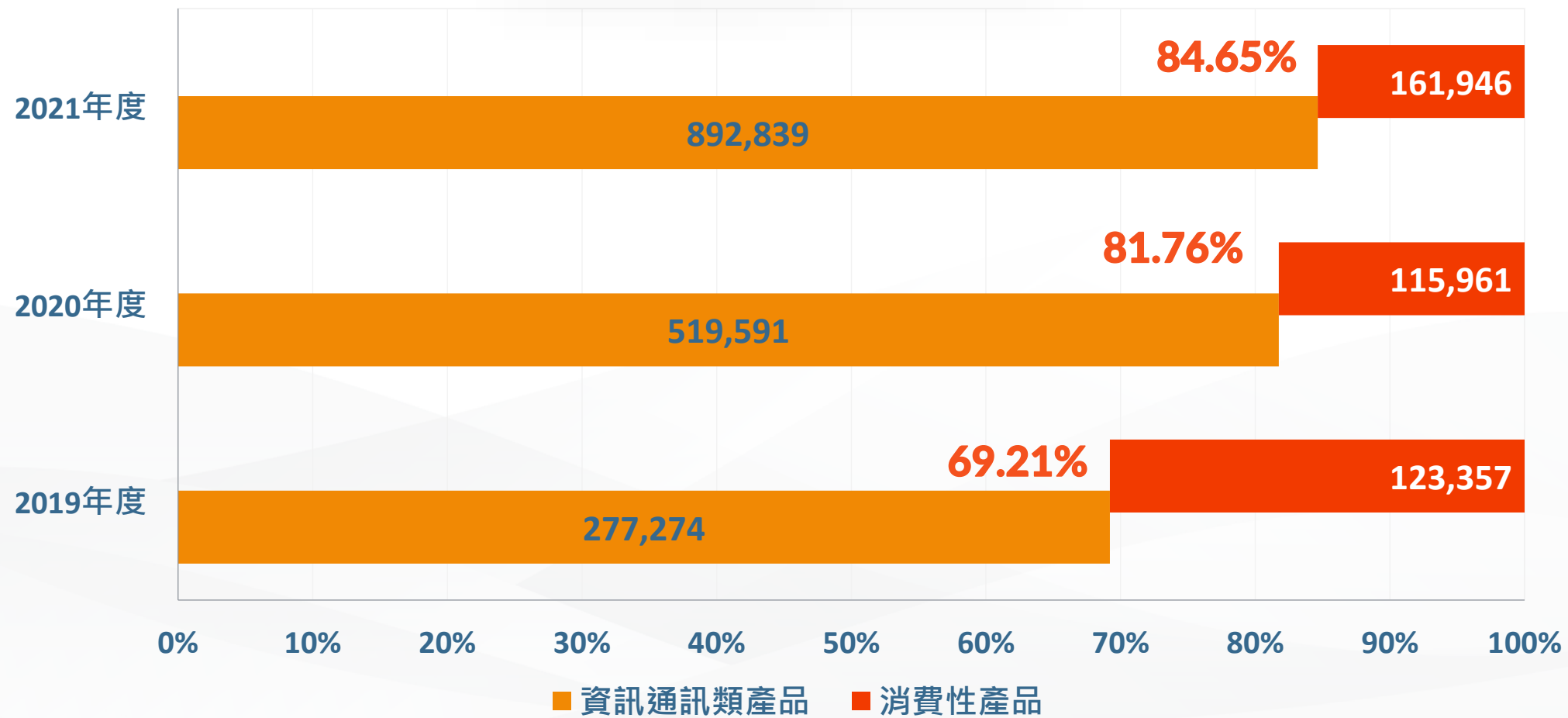


經營實績



主要產品收入分布

新臺幣千元；%



產品應用與市場概況

■ M3TEK電源管理晶片產品

■ 電源晶片應用之終端產品

■ 電源管理IC市場及應用領域

■ 全球主要終端客戶

M3TEK電源管理晶片產品



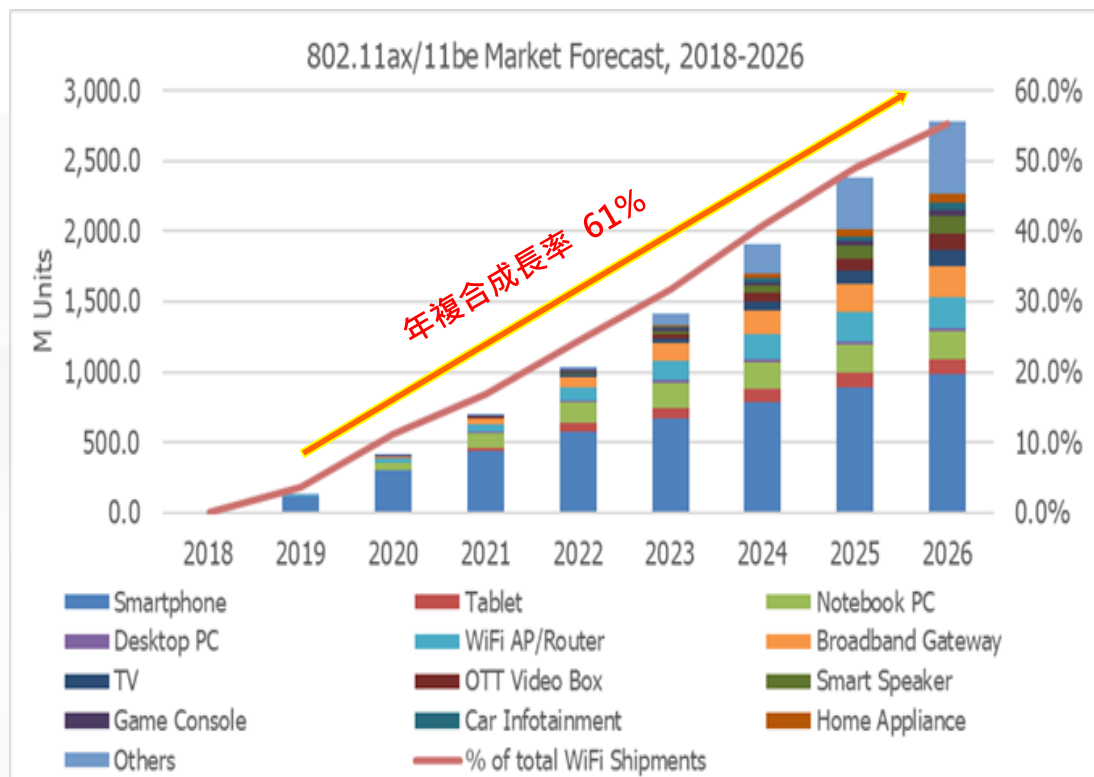
電源晶片應用之終端產品



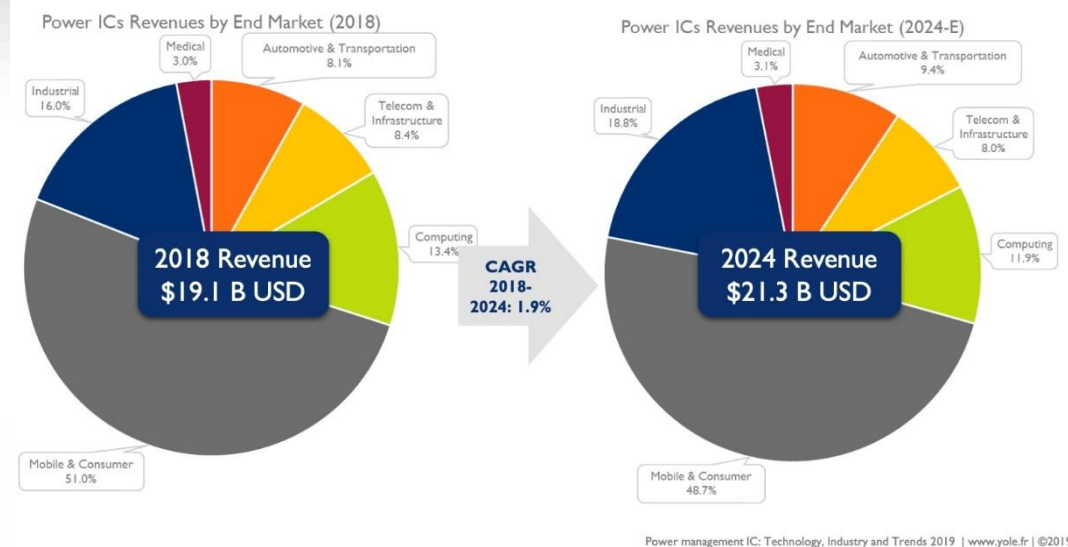
電源管理IC市場及應用領域

01

電源管理IC應用涵蓋極廣，主要應用領域為通訊與消費性、工業、運算、車用、醫療、電信；根據Yole Development 市場研究報告，2018至2024年全球電源管理IC市場穩健成長，年複合成長率約1.9%，2024年預估市場規模將達213億美金



Source: Techno System Research



02

Wi-Fi 持續世代交替

每一新Wi-Fi世代推出將會促使路由器等網路設備之換機潮，若技術層面能持續領先同業，則將能持續於該領域取得先機。

03

Wi-Fi 6功能及優勢

目前新世代標準Wi-Fi 6，相較前一代具有連線速度高、低延遲、支援更多無線設備、提高覆蓋範圍以及提升電池續航力等優點。

電源管理IC市場及應用領域

01

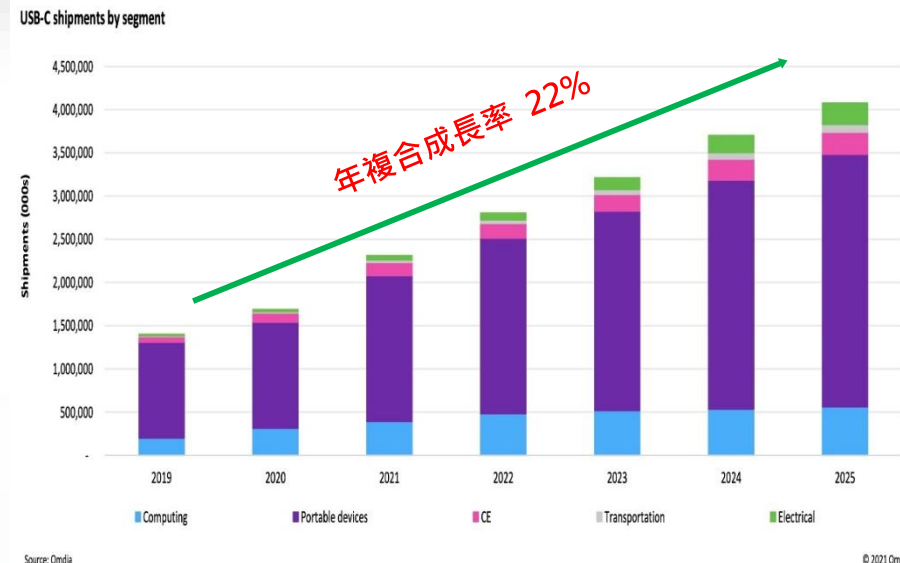
Type-C 未來趨勢

世界各國希望能統一傳輸線之規格，以減少電子垃圾產生，遂逐步推廣Type-C為統一傳輸標準。

應用領域多元

02

Type-C 陸續導入消費性電子產品、電腦、智慧型手機，以及自駕車，並進一步擴增到家事機器人與工業設備的使用，Type-C 市場成長可期。



SSD vs HDD Shipments



03

SSD售價已達甜蜜點

SSD固態硬碟售價近年來持續下降，目前銷售價格已到達甜蜜點，將有助於各終端應用加速導入SSD。

04

因WFH加速SSD普及

隨著新冠肺炎（COVID-19）改採遠端視訊會議、線上教學，加速消費者對電腦需求大增，亦促成SSD加速普及。

競爭優勢與核心技術

■ 自主研發IC設計

■ 系統高度整合性產品設計能力

■ 市場競爭者優劣勢分析

■ 研發核心

■ 已取得專利概況

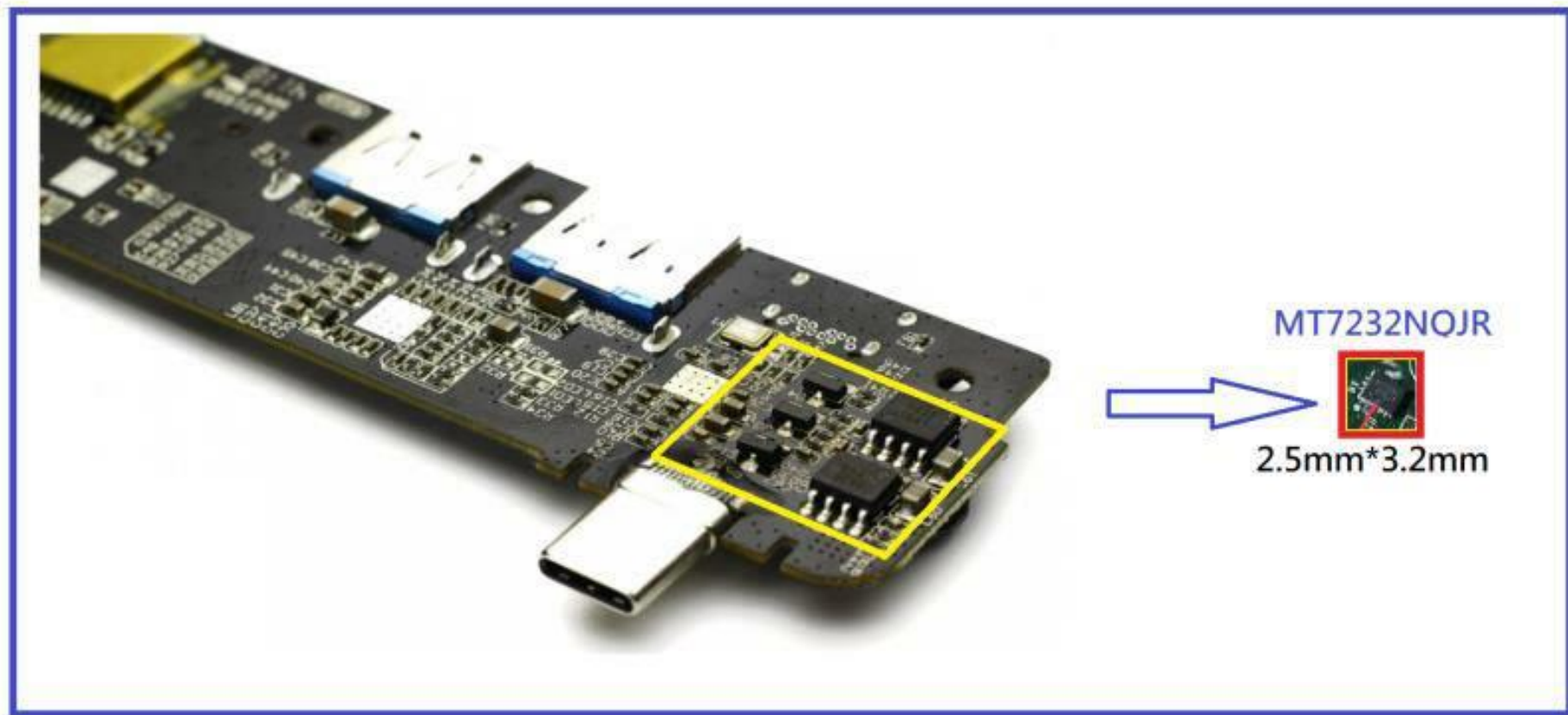
自主研發IC設計

- ✓ 與合作的8”及12”晶圓代工廠持續合作開發新一代電源管理IC製程及功率器件
- ✓ 自主開發小但散熱好的封裝設計技術和快速高品質IC測試技術
- ✓ 開發高整合度、高電壓及大電流的電源管理晶片
- ✓ 優化晶片面積、提高產品CP值
- ✓ 新產品開發迭代迅速，不易被競爭者複製
- ✓ 具備改進及優化Power IC標準製程之開發能力



系統高度整合性產品設計能力

M3TEK負載開關IC整合更多功能，比分離器件設計更可以節省其他周邊元件，協助客戶簡化設計、節省空間



市場競爭者優劣勢分析

	優勢	劣勢
◆ 市場領先者	• 品牌知名度高 • 研發團隊人力充沛 • 產品線深廣度俱足 • 上市公司財力雄厚，垂直整合產能或橫向增加產品線較為容易	• 透過經銷商銷售，對客戶黏著度相對不高 • 組織資源僵固，靈活度不足 • 議價空間小 • 決策過程長，缺乏彈性
◆ 市場新銳 來頡科技M3Tek	• 獲得世界級主晶片大廠採用為參考設計平台 • 偕同客戶自定義新產品的研發能力 • 已獲得市場規模較大的客戶實質肯定，黏著度相對較高 • 因應市場競爭，議價空間有彈性 • 年輕靈活度高的經營團隊	• 品牌知名度較低 • 公司營運規模較小 • 晶圓成本較高，選擇Fab要門當戶對

研發概況

為滿足客戶需求，勇於做Power IC架構與設計創新

研發核心

RD Core Value

M3Tek is an engineering-driven company.
Engineers interact directly with customers and
develop new products.

專利佈局

Patent Portfolios

Empower design innovation to solve customers'
engineering problems. Apply for patents to protect
product innovation.

已取得專利概況



10件

美國專利

美國尚有6件
申請中

13件

中國專利

中國尚有3件
申請中

5件

臺灣專利

臺灣尚有1件
申請中

未來發展

公司短期發展目標

公司長期發展目標

短期發展目標

- ✓ 深耕公司的主要合作客戶，提供具競爭力之產品及完善的技術服務，以提高市場占有率
- ✓ 強化行銷業務管理，將公司的產品與客戶需求緊密連結
- ✓ 提供客製化服務並滿足客戶之需求，達成以服務客戶為導向的商業模式
- ✓ 與晶圓廠與封裝測試廠維持良好且密切之合作關係，確保能取得客戶需求之產能
- ✓ 積極配合客戶在東南亞等區域進行產品量產的需求，提供適合的交易與物流配合方式



長期發展目標

- ✓ 密切關注科技發展趨勢及市場應用需求，並配合公司自主研發能力，以提供完整的產品系列
- ✓ 持續投入資源於技術開發，累積產品研發技術資料庫與專利，並與客戶討論未來產品的規格需求
- ✓ 持續強化與主晶片平台的合作，藉由新平台的合作開發可以提升研發人員對新應用之掌握度，並提升公司的品牌知名度
- ✓ 持續開發銷售通路，結合海外代理商的資源及銷售網路，並拓展歐美與日韓等新客戶
- ✓ 持續深化與晶圓廠、封裝測試廠的長期合作關係，進而成為策略夥伴



來頡科技上市目標

建立品牌形象，保持長久成長

多元員工獎酬工具，以利吸引更多優秀人才加入公司經營

強化公司治理，建立永續經營公司之營運制度

讓6799TW成為ESG成分股中客戶首選

電源管理晶片供應商

Thanks for Attention!